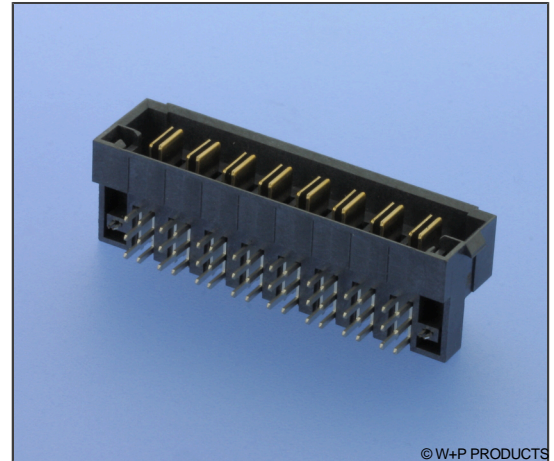


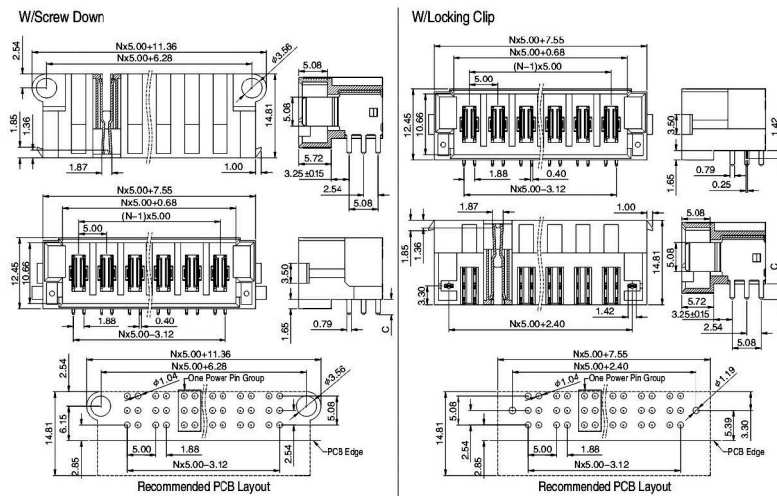
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	600 V AC / 848 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	24,7 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +105 °C (Sn Veredelung) -55 °C ... +125 °C (Au Veredelung) -55 °C ... +105 °C (Sn plating) -55 °C ... +125 °C (Au plating)
Verarbeitung <i>Processing</i>	260 °C für 10s 260 °C for 10s



© W+P PRODUCTS

Gegenstecker / Mating Connectors : 450, 451



Series	Contacts*	Terminal Type*	Plating*	Locating Option*	Packaging*
<b>453</b>	<b>06</b> 02/03/04/06/08	<b>20</b> 20 C=2.72mm 21 C=3.52mm 22 C=4.32mm	<b>00</b> 00 Au flash 50 Sn 60 Sel. Au/Sn 610 Sel. Au 10µ"/Sn	<b>30</b> 20 Locking Clips 30 Screw Down	<b>ST</b> ST TRAY

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

**Lieferformen / Packaging Options:**  
ST In Stangen / In tubes  
TRAY Auf Tray / On tray

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

